

# SEETHE INVISIBLE WORLD

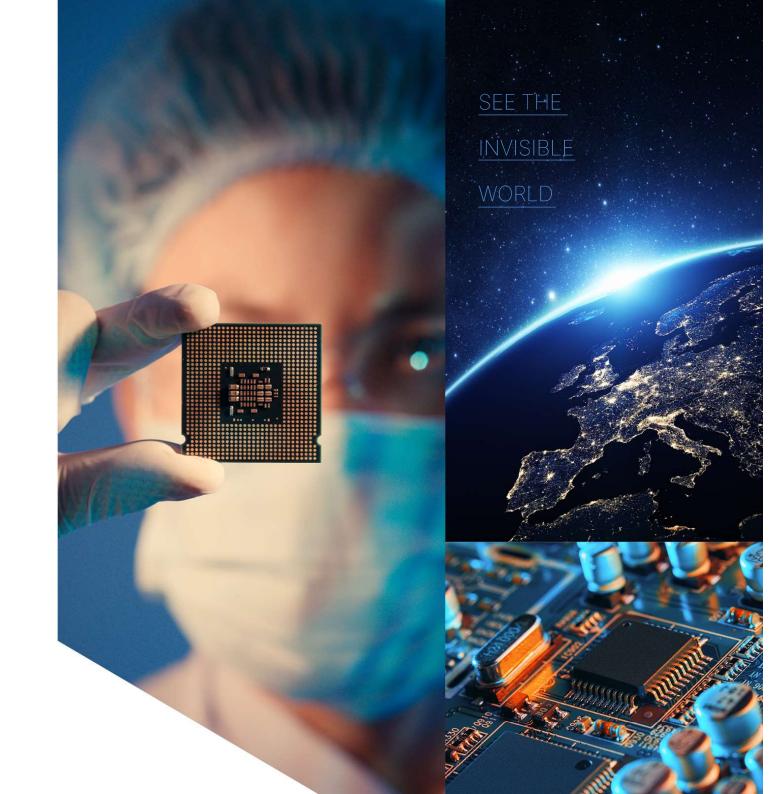
# PEMIRON

세계 최고 수준의 기술력 & 최고의 검사장비 - 펨트론

# TABLE OF CONTENTS

- 1. 경영성과 및 주요 이슈
- 2. 회사소개

P-E-M-T-R)N-



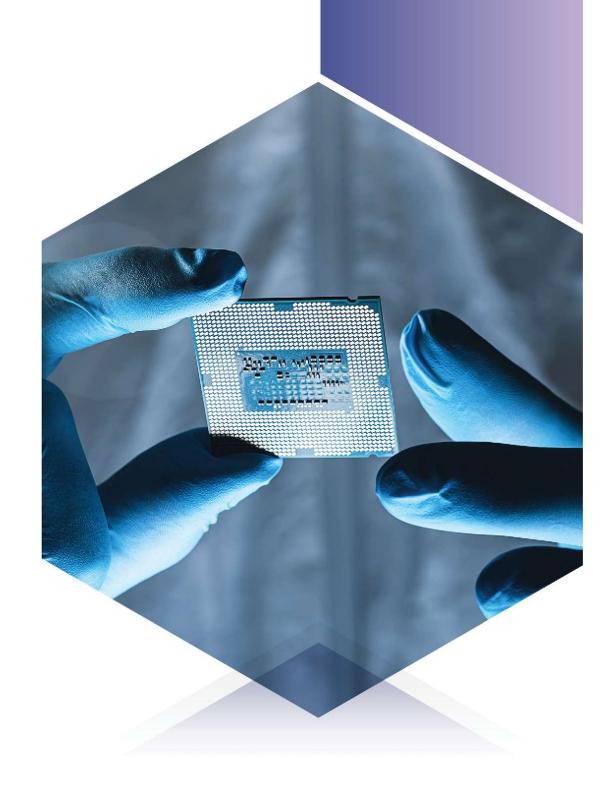
# P-E-M-T-R-)N-

01.

# 경영성과

- 1. 비즈니스 포트폴리오
- 2. 전방시장 성장
- 3. 최근 3년 경영 실적 현황
- 4. 2차전지 분야 사업 가시화
- 5. 주요 이슈



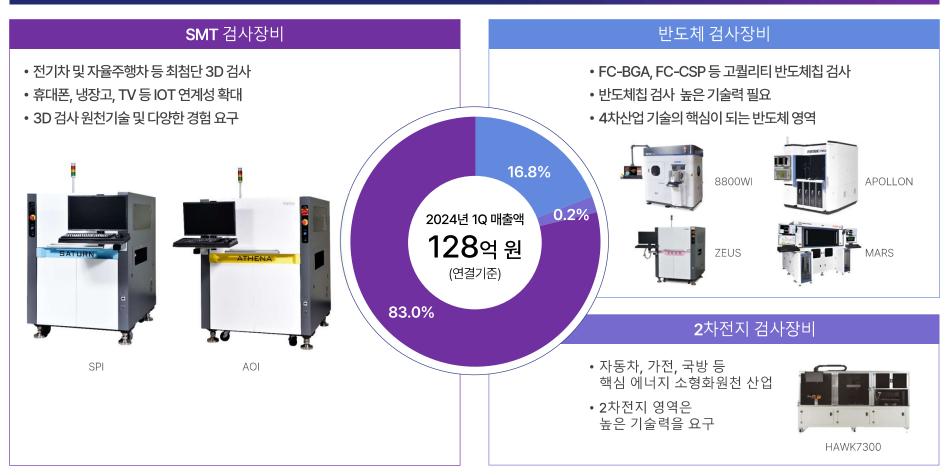






# SMT, 반도체, 2차전지 산업 등 검사장비분야 다각화로 사업 포트폴리오 구축

#### 사업영역







## 지속 성장하는 산업에 따른 성장 수혜 예상

#### 글로벌 SMT 시장 전망

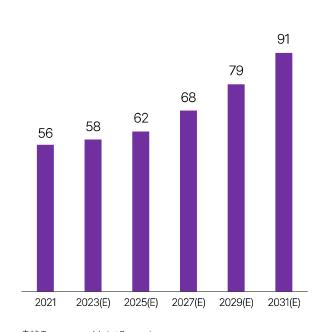
- 삼성전자 2026년까지 450조원 투자 계획
- 삼성전기 반도체 Package기판 사업 2.3조원 투자
- TSMC 올해 55조원, 내년 60조 이상 투자 계획
- SK그룹 미국에 220억 달러 투자
- 미국 반도체산업육성법안 통과(68조원 지원 사업)

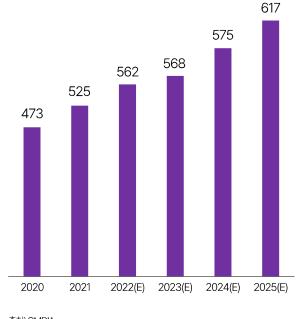
#### 글로벌 반도체 시장 전망

- 반도체 시장 규모 2030년 1조 달러 돌파 예상
- 올해 글로벌 반도체 매출 규모 사상 최초 6천억 달러 돌파 전망
- 작년 기준 세계 반도체 시장 26% 성장

#### 글로벌 2차전지 시장 전망

- 글로벌 배터리 총 출하량 2020~2031 221GWh → 3,670GWh 성장 전망
- 전기차 배터리 2020 ~ 2030 143GWh → 3,257GWh 성장 전망
- 2030년 전기차88.7%, ESS8.2%, IT기기3.0% 분포 전망





단위: 십억 달러



출처) Transparency Market Research

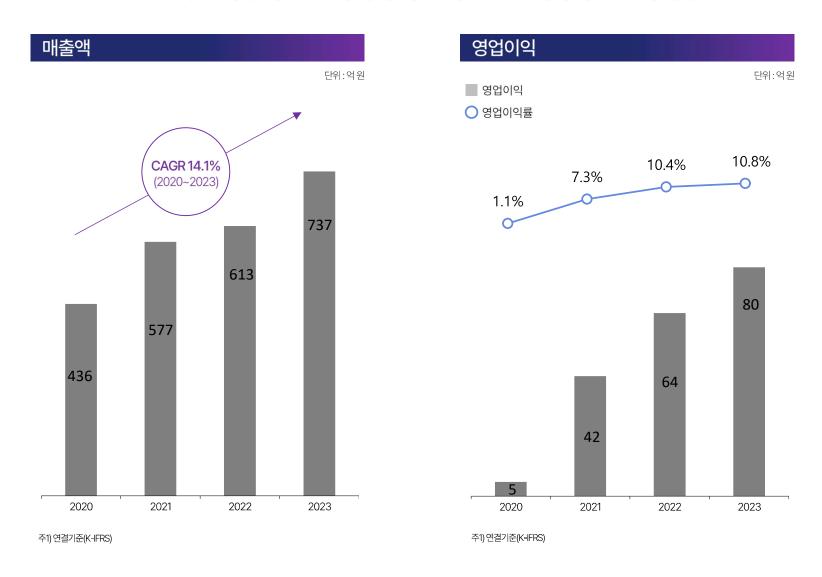
출처) OMDIA

단위: 천만 달러

5



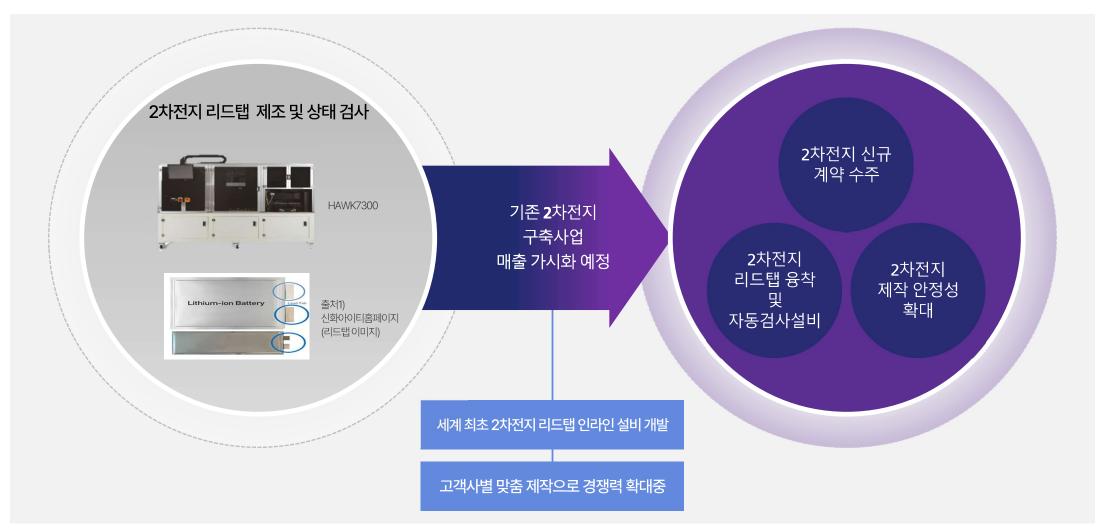
# 반도체 검사장비 납품 확대에 따른 최근 3년 지속적인 실적 성장





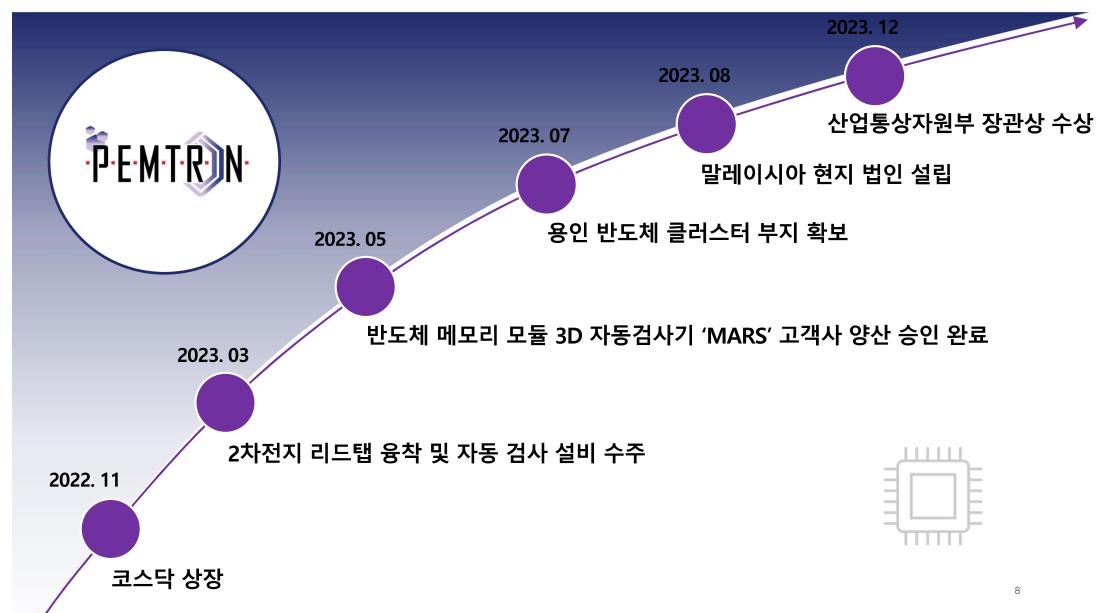


# 기존 2차전지 사업 리드탭 융착 및 자동검사설비 수주 확대









# P.E.M.T.R.)N.

02.

# 회사소개

01. 회사개요

02.회사 연혁

03. 최첨단 3D 검사장비 – (1) SMT

(2) 반도체 후공정

(3) 반도체 (FC-BGA)

(4) 2차전지

04. 체계화 된 연구소 운영

05. 최첨단 핵심기술 융합 솔루션 Model

06. 융합 솔루션 3D 검사 효율 극대화

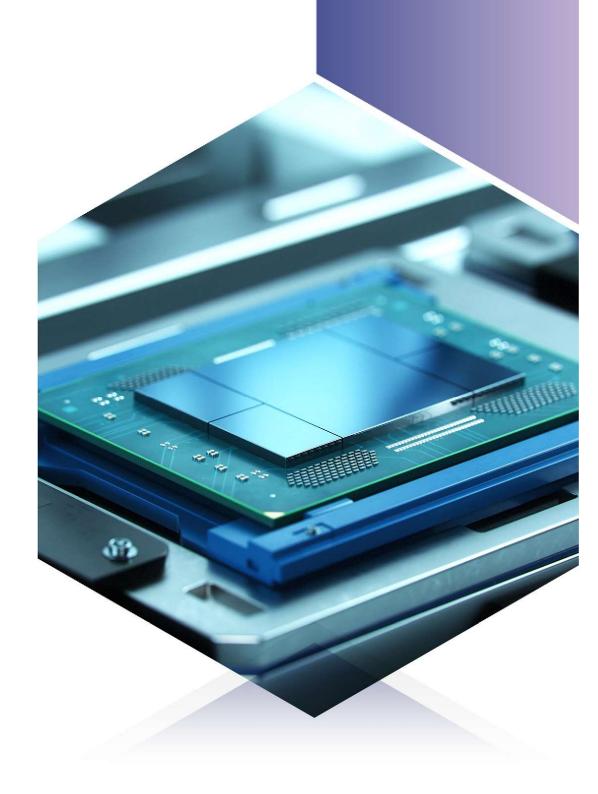
07 글로벌 네트워크 다수 확보

08. 시장 선도하는 3D 기술력

09. 글로벌 우량 고객과 협력 확대

10. 비전









# SMT, 반도체, 2차전지 등 3D 검사 역량을 보유한 펨트론

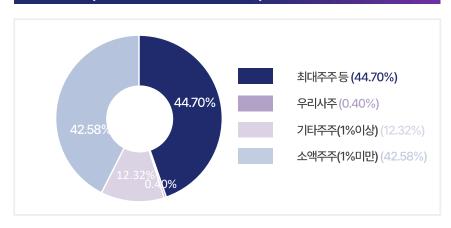
# 회사개요

회사명	(주) 펨트론 (PEMTRON Corp.)		
대표이사	유영웅		
설립일	2002년1월		
자본금	<b>53.2억원</b> (2023.12 사업보고서 기준)		
임직원수	<b>207명</b> (2023.12 사업보고서 기준)		
사업분야	SMT 검사장비/반도체검사장비/2차전지검사장비		
주요사업	SMT 검사장비	납도포상태검사장비(SPI)     부품실장상태검사장비(MOI)     장착부품검사장비(AOI)	
	반도체검사장비	<ul> <li>Wafer 검사장비</li> <li>Wire Bonding 검사장비</li> <li>Package 검사장비</li> <li>Memory Module 검사장비</li> </ul>	
	2차전지검사장비	• Lead Tab제조 및 검사장비	
본사주소	서울시 금천구 가산디지털1로 219, 1406호 (가산동, 벽산디지털밸리6차)		
홈페이지	http://www.pemtron.com/		

#### 대표이사



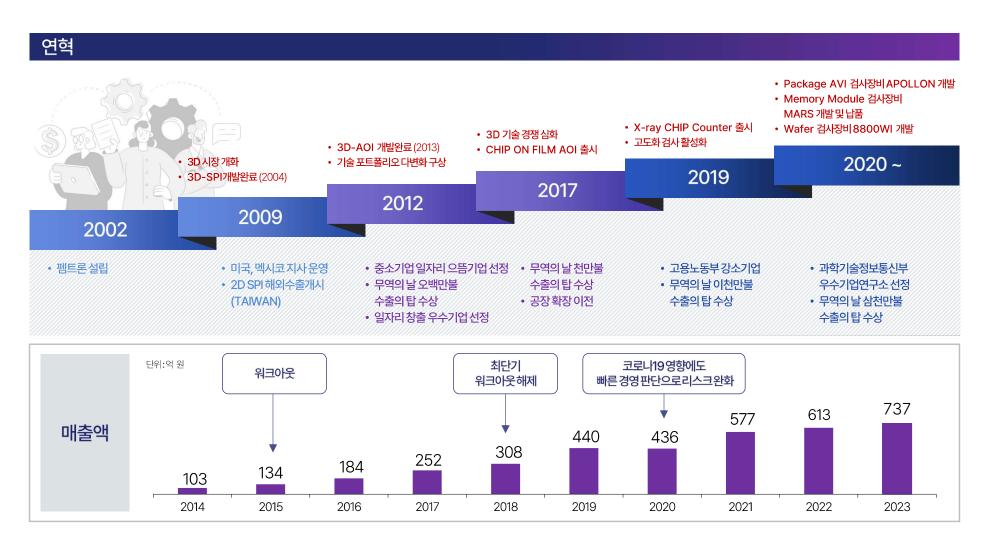
# 지분구조(2023년12월31일 현재)







# 기술 고도화 역량으로 꾸준한 성장동력 확보







# SMT 및 FC-BGA 검사 고도화 장비

#### SMT 공정과 펨트론 주요 장비 라인업 Reflow AOI Screen SPI MOI Mounter Printer Soldering SPI 납도포상태검사장비 MOI 부품 실장상태 검사장비 AOI 장착부품 검사장비 • Moire방식 3D 측정 • 광학비전 구현 • 1.1um ~ 18um Resolution 대응 • 전 모델 Moire 8-Way Projection • 세계 최초 Real Color • Full 3D + Full 2D 검사방식 • 선명한 3D 이미지 구현 3D 영상 구현 • 세계 최고 속도 0.25sec/FOV • 업계 최고 속도 0.5sec/FOV • 마운터 Bad Mark 연동 • 사용자 요구에 따른 UI 적용



# 반도체 공정 Wafer와 Wire Bonding, Package, Memory Module 검사장비

#### 반도체 공정과 펨트론 주요 장비 라인업 Mid-end Back-end Front-end After-process Memory Wafer ••• **Package** ••• •••• 파이널 설계 제조/생산 Module 조립 패턴 검사 검사 (Design) (Fab) 검사 검사 8800WI **ZEUS APOLLON MARS** Memory Module 자동 검사 Wafer sawing 전/후 검사 Wire Bonding, MEMS 자동 검사 Package 자동검사 • 정확한 검출력 • 장비 내 이물 관리 위한 FFU 장착 • 각종 Memory Module 검사 • 가성불량 최소화 • 이물 추가 제거 위한 Over Kill 최소화 • 반복 및 검증 가능한 • 업계 최고의 • Auto Cleaning 기능의 ionizer 사용 표준 수립 속도 0.5sec/FOV • 장비 내 NG 제품의 2차 판정 기능 및 • 공정 제어 및 운영 효율성 향상 • SECS/GEM 적용 • 자동 Sorting 기능 • 신뢰할 수 있는 정확한 부품 높이 측정

<sup>\*</sup>MEMS : Micro Electro Mechanical Systems (미세 전기 기계시스템)의약자로,미세한입체구조 (3차원구조)를지니며, 다양한입력·출력 신호를 취급하는시스템의 총칭



# FC-BGA 산업 등 검사장비분야 다각화로 사업 포트폴리오 구축

#### FC-BGA 반도체기판 트렌드

FC-BGA, FC-CSP Package 기판 확대 연결방식에 따라 노이즈, 경량화, 속도처리 등 향상 와이어, 범프 연결 방식으로 칩과 Package 연결방식 고도화 EPS, EDS 등에 반도체와 부품을 하나의 시스템 패키징 고도화

**POSEIDONS** 



FC BGA PCB Strip / Qurd Type 의 초도 및 BUMP 검사 장비 8800FI



FC BGA PCB ,Strip / Qurd 의 Scale 측정 분류 장비 **1M NIWT0088** 



반도체 공정의 FLUX, Metal Mask 검사기 8800AI



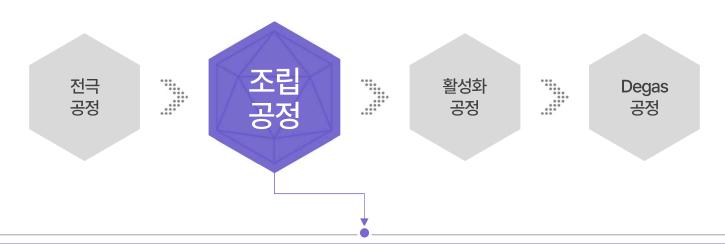
다양한 조명의 조합, 개별적용을 적용한 PCB제품 외관 검사 장비





# 세계최초 2차전지 리드탭 검사장비 및 리드탭 제조장비

#### 2차전지 공정과 펨트론 주요 장비 라인업



#### HAWK7300 2차전지리드탭 제조 및 상태검사

- 세계 최초 2차전지 Lead Tab In Line 검사기
- 개당 생산 속도 1.6sec의 가장 빠른 검사속도 보유
- 확장성 높은 설계 기술 보유
- 특정 배율 선택 가능 (x100, 200, 500, 1000, 2000, 5000배)









# 체계화된 기술연구소 운영과 전문화된 S/W개발인력 집중 투자

# 

#### 주요 역량



**전문연구인력 104명** (S/W인력 64명)



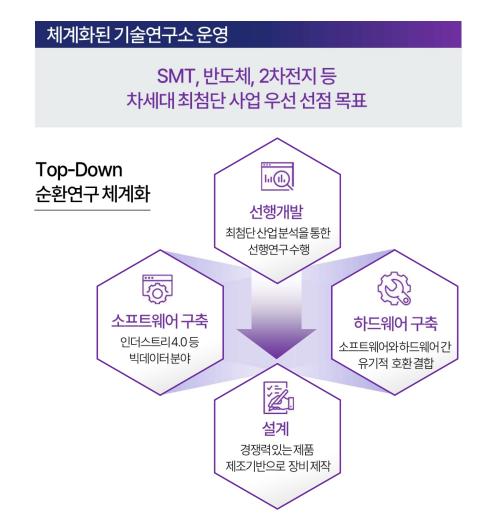
특허등록 60여개 이상 (출원포함)



R&D 투자 13% 상회 (2023년 매출대비)

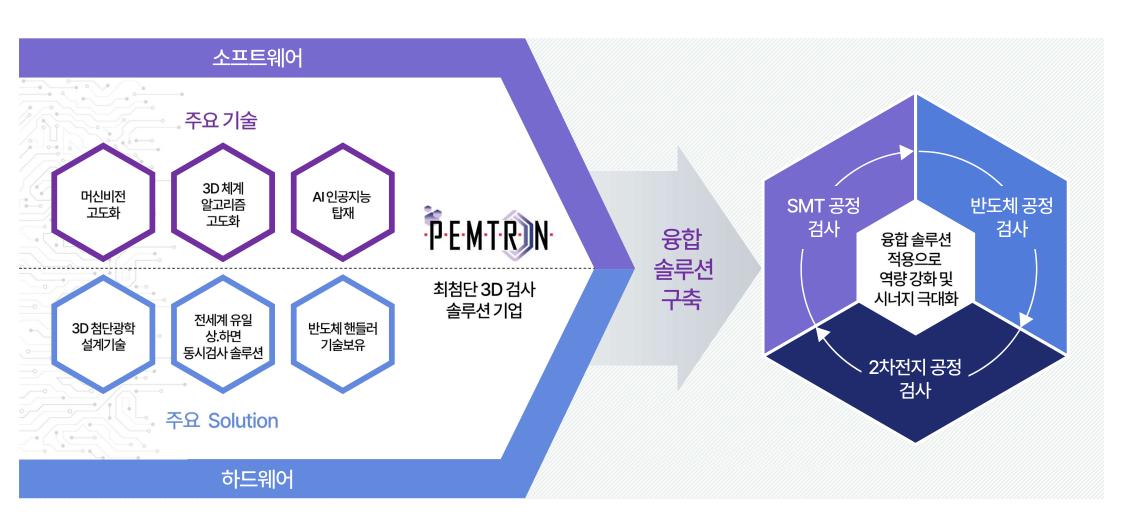


생산시설 2,000평 이상 (2021년 확장)











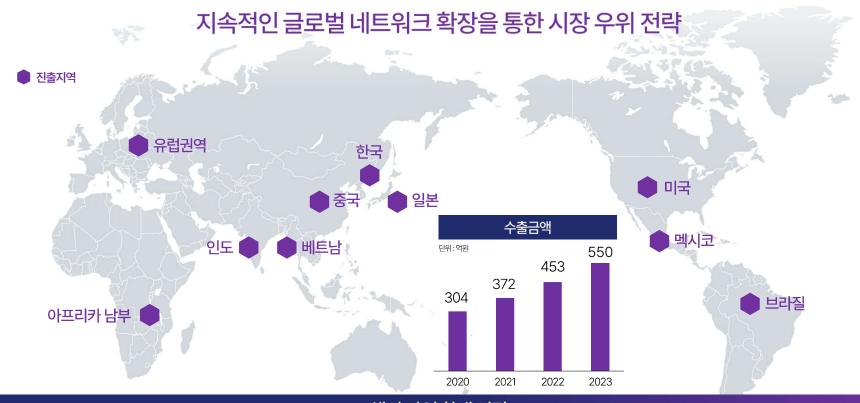
# 소프트웨어와 하드웨어 융합 시너지 퍼포먼스



최첨단 3D 검사장비 효율 극대화







#### 해외 사업 확대 전략



#### 아시아 권역

- 베트남포함동남아진출로글로벌인지도확보
- 2011년부터 MIDEA, KAIFA 등글로벌기업 네트워크지속형성
- 한국과대만등글로벌투자지속확대



#### 미주 권역

- 미국, 멕시코 등 초기 투자로 시장 선점
- 미국자동차 및 반도체 산업 동맹 등 전략적 관심



#### 유럽 권역

- 한국, 중국, 미국 등 네트워크 경험 역량으로 유럽권 네트워크확대
- 글로벌 1위 기업 파트너십 체결





# 최첨단 3D 기술 우위를 기반으로 선두주자 지위 지속

#### 최첨단 기술선도 경쟁력

- 경쟁회사 대비 검사방식 및 속도 등이 월등하고 가격 경쟁력까지 확보
- 2D+3D 조명 이용 기술로 타사 대비 우수한 실사 수준의 이미지 구현
- 정밀도(반복도)면에서 경쟁회사 대비 기술력을 확보해 반도체 Package 검사 분야와 Wafer 등 초정밀 반도체 검사 분야까지 산업 내 다각화 실현
- Moire 원천기술을 이용하여 경면(거울면) 및 2010 Chip 검사에서 뛰어난 기술력을 입증

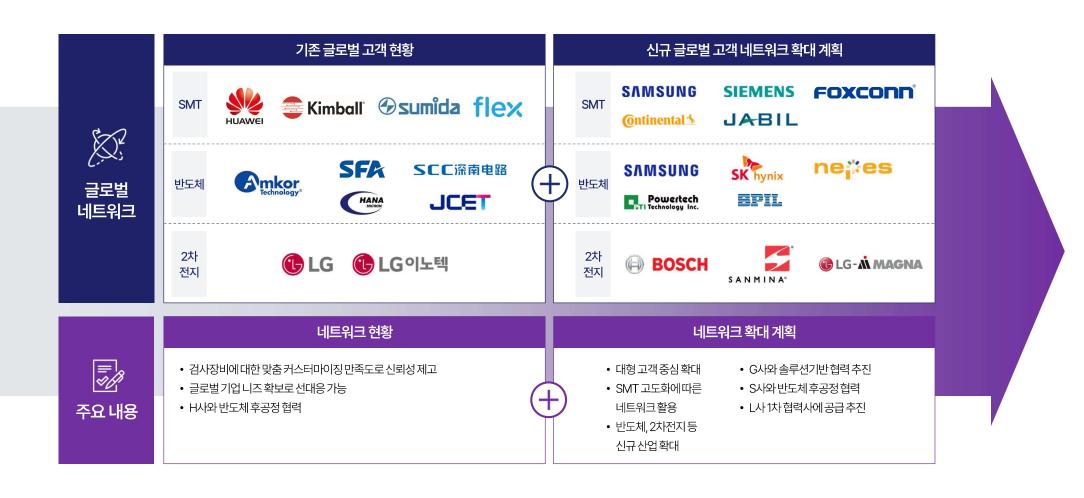
구분	<u>펨트론</u>	K사	PA
제품명	ATHENA	ZENITH	XCEED
검사방식	Moire	Moire	Laser
3D 정밀도	4/8/12 Projection	4/8 Projection	Dual Projection
2D조명	Top, Middle, Botton 3단 RGB	Top, Middle, Botton 3단 RGB	RGB 3색
기판휨검사	Full FOV 3D 검사	Spot FOV 3D 검사	Full 3D 검사
검사속도(15um기준)	36~54cm²/SEC	27.6~51.9cm²/SEC	65cm²/SEC
광학계정밀도	10/5/3/2/1um Resolution	5um Resolution	7um Resolution
응용검사분야	초정밀반도체 Package	일반적인 Package	일반적인 Package
3D 이미지		John Jakelin	

주1) 3D정밀도: 숫자가클수록 우위 주2) 광학계정밀도: 숫자가작을수록 우위





## 글로벌기업과 긴밀한 파트너십으로 독보적 신뢰성 확대





2025Y! 최첨단 3D 검사장비 글로벌 NO.1

SMT 분야 글로벌 NO.1 반도체 검사장비 매출 증대 2차전지 분야 포트폴리오 확대



4차산업 대응 최적화 구축



반도체,자율주행, 의료 등 산업 확대



AI기술고도화로 첨단화구축



글로벌 거래처 확대로 인지도 제고